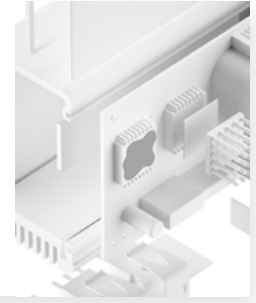


dispensierbar

TGL-U-NS ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger, hochviskoser, dispensierbarer und silikonfreier Form-in-Place Gap-Filler mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Der fertige Compound erfordert keinen zusätzlichen Vernetzungsprozess. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Bei Aufbringung des dispensierbaren, viskoplastischen Materials wird ein optimaler thermischer Kontakt ohne Druckaufbringung erzielt. Durch seinen Einsatz wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert.



EIGENSCHAFTEN

- Dispensierbar
- Fast drucklose Aufbringung durch Viskoplastizität
- Wärmeleitfähigkeit: 4,0 W/mK
- Kein zusätzlicher Vernetzungsprozess

LIEFERFORMEN

- Kartuschen 330 ml
- Auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- SMD Bauteilen
 - Through-hole Vias
 - RDRAM Speicherbausteine
 - Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
- z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer/ 5G Telekommunikationsausrüstung

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGL-U-NS
MATERIAL		
MATERIAL		Keramik gefüllter silikonfreier Compound
Farbe		Grau
Dichte	g/cm ³	2,9
Viskosität (@ 0,5 1/s) (@ 1,0 1/s)	Pas	3.300 2.500
Haltbarkeit (ungeöffnet, trocken gelagert @ 5 – 30°C)	Monate	6
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja
THERMISCH		
Thermische Leitfähigkeit ¹	W/mK	4,0
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 125
ELEKTRISCH		
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	8
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	1,0 x 10 ⁹
Dielektrizitätskonstante	@ 500 MHz / @ 1 GHz	8,98 / 8,88

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.